

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-013

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度 及相关授权事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保额度。该议案需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、申请授信及相关担保情况的概述

鉴于公司业务扩展需要，提高公司生产经营运作效率，做好资金供应保障，公司拟向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度。另外，为顺利推动公司生产经营过程中的融资计划，公司拟为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保额度。前述担保额度包含：公司为控股子公司提供担保；控股子公司为本公司提供担保；控股子公司之间的相互担保。对非全资子公司提供担保时，该非全资子公司其他股东需按照持股比例提供担保。

现提请授权董事长或董事长指定的代理人，在上述 13 亿元的综合授信额度以及 10 亿元的担保额度内，根据实际经营需要决定每一笔授信或担保的具体事宜，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签署的法律文件为准。

上述授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，超过上述综合授信额度及担保额度的部分，仍需按照《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的审议权限提交董事会或股东大会审议。

本议案审议通过后尚需提交 2023 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

担保预计基本情况如下：

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	担保方	本次授权的担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广州创想云科技有限公司	100%	22.73%	500	惠伦晶体	3000	3.37%	否
惠伦晶体（重庆）科技有限公司	100%	62.14%	30000	惠伦晶体	45000	50.55%	否
惠伦晶体科技（深圳）有限公司	65%	95.47%	0	惠伦晶体	2000	2.25%	否

二、被担保人基本信息

（一）广州创想云科技有限公司

公司名称：广州创想云科技有限公司

统一社会信用代码：91440101633202999B

类型：有限责任公司

法定代表人：潘毅华

注册资本：人民币3000万元

成立日期：1997年5月20日

注册地址：广州市天河区中山大道西89号4层421房

经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；电子设备工程安装服务；电子产品零售；信息系统集成服务；安全技术防范产品制造；消防设备、器材的制造；消防设备、器材的批发；通信工程设计服务；消防设备、器材的零售；计算机网络系统工程服务；软件开发；通信设备零售；监控系统工

程安装服务；租赁业务。

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日 (已审计)	2022年12月31日 (已审计)
资产总额	94,389,330.04	82,925,251.33
所有者权益	71,508,874.26	67,719,947.73
归属于母公司所有者权益	71,508,874.26	67,719,947.73
项目	2023年1-12月 (已审计)	2022年1-12月 (已审计)
营业收入	37,611,618.38	34,984,787.32
净利润	3,788,926.53	1,761,730.65

(二) 惠伦晶体(重庆)科技有限公司

公司名称：惠伦晶体(重庆)科技有限公司

统一社会信用代码：915500110MA60Y86A50

类型：有限责任公司

法定代表人：韩巧云

注册资本：人民币20000万元

成立日期：2020年6月2日

注册地址：重庆市万盛经开区鱼田堡高新技术产业园

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料研发；物联网技术研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；光电子器件销售；住房租赁；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日 (已审计)	2022年12月31日 (已审计)
资产总额	1,105,728,192.46	1,047,478,828.93
所有者权益	418,626,504.98	361,875,691.22
归属于母公司所有者权益	418,626,504.98	361,875,691.22
项目	2023年1-12月 (已审计)	2022年1-12月 (已审计)
营业收入	143,936,328.41	106,199,085.60
净利润	-85,804,738.03	-45,789,090.51

(三) 惠伦晶体科技(深圳)有限公司

公司名称: 惠伦晶体科技(深圳)有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5GLXT85H

类型: 有限责任公司

法定代表人: 韩巧云

注册资本: 500万元人民币

成立日期: 2021年02月23日

注册地址: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区南山高新北区科苑大道与宝深路交汇处酷派大厦A座A1706

经营范围: 一般经营项目是: 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。机械设备、五金产品、电子产品批发、销售。许可经营项目是: 无。

主要财务数据:

单位: 元

项目	2023年12月31日 (已审计)	2022年12月31日 (已审计)
资产总额	65,059,805.64	21,420,286.13
所有者权益	2,948,096.53	184,817.83
归属于母公司所有者权益	1,916,262.75	184,817.83

项目	2023 年 1-12 月 (已审计)	2022 年 1-12 月 (已审计)
营业收入	68,019,678.06	24,850,622.64
净利润	-1,236,721.30	63,749.32

三、对公司的影响

本次公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜,是为了满足公司的经营资金需求,提高公司生产经营运作效率,不会对公司日常经营产生不利影响,同时有利于公司持续、健康、稳定发展,对公司的经营活动产生积极影响,风险可控,符合公司和股东的利益需求,不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

四、担保的主要内容

上述综合授信及担保额度经股东大会通过前提下,授权公司董事长或董事长指定的代理人根据实际经营需要决定每一笔授信或担保的具体事宜,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。上述计划综合授信及担保额度仅为公司及控股子公司拟申请的综合授信额度和担保额度,具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及子公司的实际担保余额为 72,850 万元,占公司 2023 年经审计净资产的 81.84%。除前述外,公司及控股子公司无其他对外担保及逾期对外担保的实际数额。

六、董事会意见

董事会认为:为提高公司生产经营运作效率,公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度,并为融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保额度,有利于公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力;公司对子公司日常经营具有绝对控制权,担保风险可控。

七、独立董事意见

独立董事认为:公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度,并为融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保额度,有利于公司及控股子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进,不会对公司产生

不利影响，不会影响公司持续经营能力；公司对控股子公司日常经营具有绝对控制权，担保风险可控。综上所述，我们一致同意公司本次向金融机构及融资机构申请授信额度及相关授权事宜，并同意将其提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为：为公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，并为融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保额度。前述担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日